

LGA7529 插槽及硬件

TE Connectivity (TE) 专为新一代服务器处理器设计的 LGA7529 插槽，主板与处理器间提供更多的连接密度。该插槽具备 7,529 个引脚，通过更高的性能与数据带宽，支持下一代多核架构处理器及高吞吐量负载，支持数据中心和人工智能 (AI) 的最新服务器架构。

应用

- 超大规模/数据中心
- 网络设备
- 人工智能/机器学习
- 边缘计算
- HPC
- 云服务
- 服务器
- 交换器

了解更多

- [访问页面](#)

特征与优点

高性能

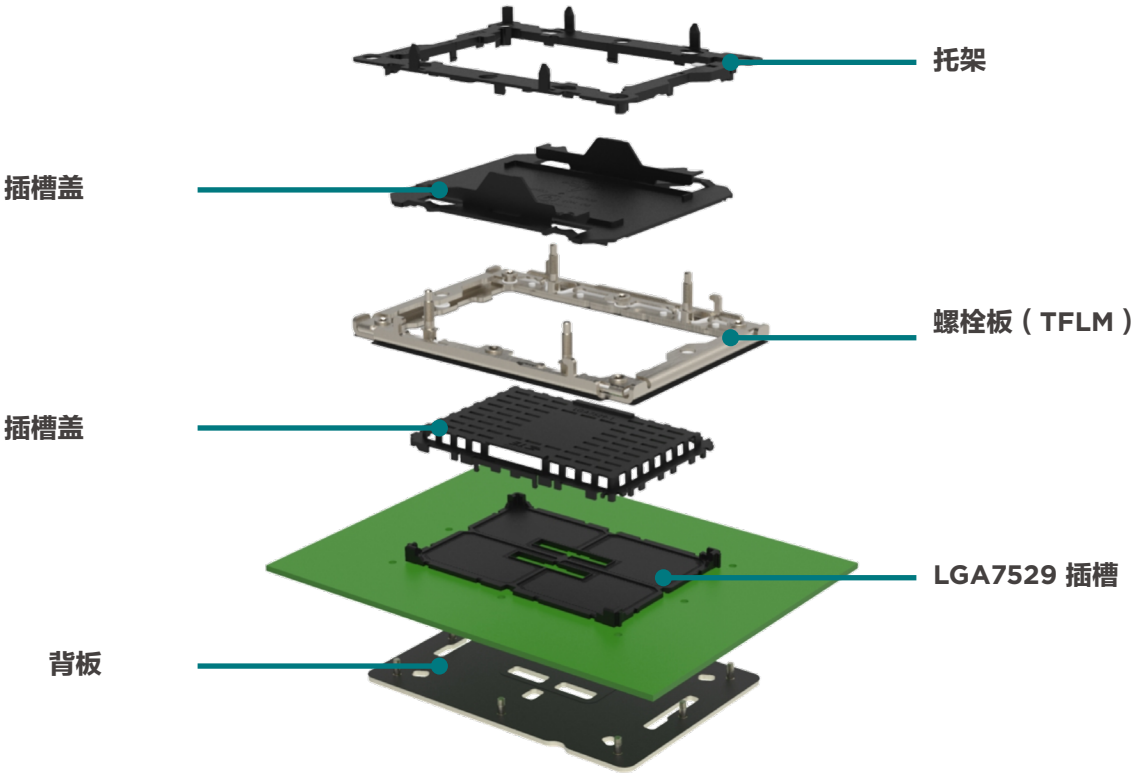
- 引脚数量多，可增强 CPU 与其他组件的互连能力
- 高扩展性可满足下一代处理器的升级需求
- 改进热管理设计，保障高性能运行稳定性

下一代硬件兼容性

- 支持 PCIe 5.0 技术：提供更高传输速率与效率，确保与先进 GPU、网卡及存储设备兼容
- 支持 12 通道 DDR5 DRAM 内存：实现处理器与多内存通道的高带宽连接

可靠且易于安装

- 已通过耐用性、抗环境影响、抗冲击和抗震测试
- 支持自动组装流程，便于安装，控制返工率
- 持续优化成本



	型号	部件描述
LGA7529 插槽	2375157-1	LGA7529 插槽, 30u" 镀金
LGA7529 硬件	1-2376820-1	LGA7529 螺栓板 (无防尘盖)
	1-2376820-2	LGA7529 螺栓板 (有防尘盖)
	2376821-1	背板 (PCB: 2.36mm - 2.74mm) (PCB: 0.093" - 0.108")
	2376821-2	背板 (PCB: 2.77mm - 3.15mm) (PCB: 0.109" - 0.124")
	2376821-3	背板 (PCB: 3.175mm - 3.556mm) (PCB: 0.125" - 0.140")
	1-2376822-1	LGA7529 载架 BR1A
	2376823-1	LGA7529 载架 BR1B
	2376822-2	LGA7529 插槽盖

常见问题

- **问：**镀金厚度是 15 u" 还是 30 u"？
答：30 u"。
- **问：**能否将其他厂商的硬件与 TE 的 LGA7529 插槽对配使用？
答：建议全程采用 TE CPU 插槽及硬件，以获得最佳服务支持。
- **问：**支持哪些 CPU 平台？
答：TE 的 LGA7529 插槽支持新一代服务器处理器：Birch Stream 系列；CPU 代号：Granite Rapids-AP/Sierra Forest-AP/Clearwater Forest-AP。
- **问：**LGA7529 插槽外壳尺寸是多少？
答：112.5mm x 75.5mm。
- **问：**LGA7529 插槽是否支持 DDR 与 PCIe 5.0 技术？
答：TE 的 LGA7529 插槽全面支持 DDR5 内存及 PCIe 第五代（Gen5）标准。

te.com

TE、TE Connectivity、TE Connectivity（标识）和 EVERY CONNECTION COUNTS 是由 TE Connectivity 集团公司拥有或授权的商标。
此处提到的其它产品、标志和/或公司名称为其各自所有者的商标。

本白皮书中的信息，包括仅为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表，据信为可靠信息。

但是，TE Connectivity 不对这些信息的准确性或完整性做出任何保证，且不对这些信息的使用承担任何责任。TE 的义务只在该产品的 TE 的标准销售条款和条件中规定，且在任何情况下，TE 均不对产品销售、转售、使用或误用造成的偶然的、间接性的或结果性的损失承担赔偿责任。TE Connectivity 产品的使用者应自行评估并确定每种产品是否适用于特定用途。

© 2025 TE Connectivity. 版权所有。

发布日期：02-25